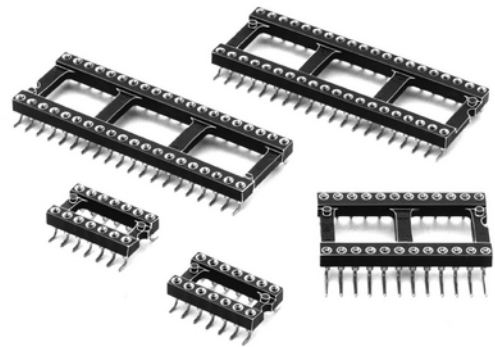


SMT IC-Fassungen RM 2,54mm - Präzisionskontakte in Gull Wing Ausführung SMT IC Sockets 2.54mm Pitch - Gull Wing Screw machined Contacts

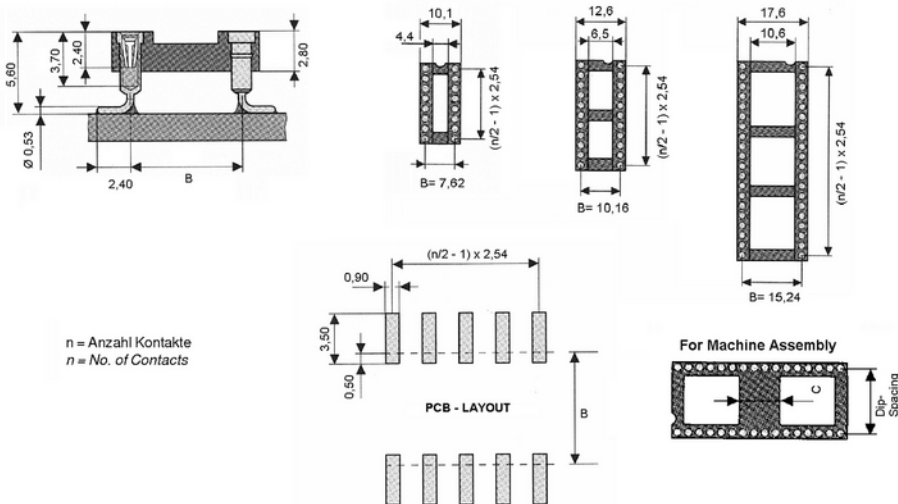
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Contact Material	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	IEC 60512-12A
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



For Machine Assembly		
No. of Contact	Dimensions	
	B	C
08	7,62	10,10
14	7,62	10,10
16	7,62	10,10
18	7,62	10,10
20	7,62	10,10
24	7,62	10,10
24	15,24	17,70
28	7,62	10,10
28	15,24	17,70
32	15,24	17,70
40	15,24	17,70

Series	Contacts*	DIP-Spacing*	Assembly*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Packing
3240	28	4	1	50	00	ST
	04/06/08/10/ 14/16/18/20/ 22/24/28 =====> 22/24/28/32 =====> 24/28/32/36/ 40/42/48 =====>	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm	1 Handbestückung Manual assembly 2 Automatenbestückung verfügbare Typen s. Tab. Machine assembly see table for available types	50 Verzinkt Tin plated	00 Vergoldet Gold plated 10 0,25µm Gold 0,25µm gold plated 30 0,75µm Gold 0,75µm gold plated	ST Verpackt in Stangen Packed in tubes

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

